

材料科学与工程学院（系）辅修学位（专业）教学计划

电子封装技术 专业

序号	课程编码	课程名称	课程类别	学时	学分	建议选课长学期
1	MS31008	传输原理	专业基础	48	3	3秋
2	MS31007	材料科学基础B	专业基础	64	4	3秋
3	MS31019	固体物理导论B	专业基础	32	2	3秋
4	MS31204	半导体器件物理	专业基础	40	2.5	3秋
5	MS31202B	微电子制造技术	专业基础	40	2.5	3秋
6	MS32201	电子封装结构与设计	专业核心	40	2.5	3春
7	MS32202	电子封装可靠性	专业核心	40	2.5	3春
8	MS32203B	微纳连接原理与方法	专业核心	40	2.5	3春
9	MS33207B	MEMS和微系统封装	专业选修	16	1	3春
10	MS33212	光电子器件与封装技术	专业选修	16	1	3春
11	MS33206B	微纳加工技术	专业选修	32	2	3春
12	MS33205	电子封装材料	专业选修	32	2	3春
13	MS33219	先进连接概论	专业选修	16	1	3春
14	MS33204	表面组装技术	专业选修	16	1	3春
15	MS33214	混合微电路技术	专业选修	16	1	4秋
16	MS33217	纳米器件	专业选修	16	1	4秋

总学分合计： 31.5

完成以上总学分方可取得辅修学士学位资格；完成 21.5 学分方可申请辅修专业证书。

注：课程类别：专业基础课、专业核心课、专业选修课（辅修专业学分不包含此类课程）；